

Electroformed Bond Blades

Z05SERIES

选择范围更广的高性能切割刀

Z05系列具有优越的切削能力，能够适用于从硬脆材料到半导体基板等多种材质的切割加工

透过新技术的投入，使用者能在Z05的两种类型中进行选择。
能够广泛适用于从硬脆材料到多种半导体封装组件的切割加工。

●标准型 (D1结合剂)

- 集中度的选择范围最大可以分为6个等级，通过对集中度进行细分化，能够使用户获得更多的选择余地。
- 加工硬脆材料时，能够向用户提供既保证加工品质，又拥有较长使用寿命的切割刀片。

●更加重视加工质量型 (D1A结合剂)

- 通过抑制切割刀片刀刃部分的形状变化，能够稳定，持久地保持良好的切削性。
- 在降低树脂毛边及金属毛边等方面，也能够发挥其作用。



■集中度范围



在切割加工中，集中度会影响磨粒层的消耗速度（使用寿命）及工件的加工质量（崩缺-chipping尺寸），运用高精度集中度控制技术能够使切割刀片消耗量及工件加工质量更趋向稳定。

※集中度是指在切割刀片磨粒层中，金刚石（钻石）磨粒所占有的体积比例值。例如，集中度100就是表示在切割刀片磨粒层中，金刚石（钻石）磨粒所占有的体积为25 %

加工对象

多种半导体封装组件、生陶瓷、硬脆材料、其它材料

技术规格

结合剂			外径	厚度	厚度精度	内径	刀刃角度 θ	表面处理	
D1	可从多种集中度产品中进行选择							无	单面磨粒突出型
D1A	更加重视加工品质		54	0.1	A3	40	45	L	研磨型
Z05 - SD 700 - D1A - 105			54	0.1	A3	40	45	E	L
S3									
磨粒种类	颗粒大小		集中度				刀刃形状 ^{※1}	切口 ^{※2}	
SD	人造金刚石 (钻石)		30				E	S1 切口数量 4	
B	氮化硼 (cBN)		60				N	S2 切口数量 8	
	360	#360	90				M	S3 切口数量 16	
	400	#400	120				V	S4 切口数量 60	
	500	#500	150				S	S5 切口数量 12	
	600	#600	180					S5 切口数量 40	
	700	#700	D1A 105					S5 深度 1mm	
	800	#800						SS 特殊规格	
	1000	#1000						SS 特殊规格	
	1200	#1200						SS 特殊规格	
	1500	#1500						SS 特殊规格	
	(mm)							SS 特殊规格	

※1 刀片厚度大于0.1 mm时方可使用。
※2 切口宽度均为0.5 mm (SS型除外)

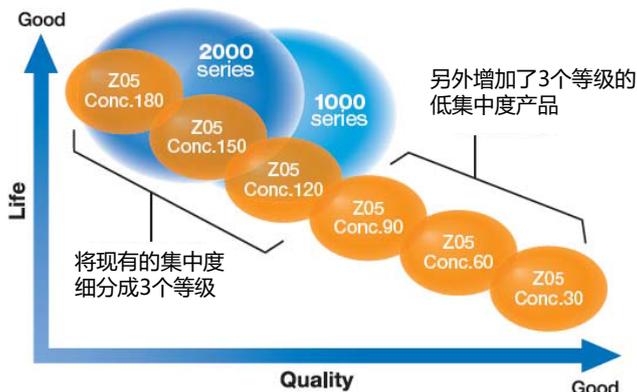
特点

能够在Z05的两种类型中进行选择。

Z05series

标准型 (D1结合剂)

部分产品的集中度只能从2个等级中进行选择，Z05系列将现有产品的集中度选择范围更加细分化，通过增加低集中度产品，形成了具有最大6个等级的集中度产品群。

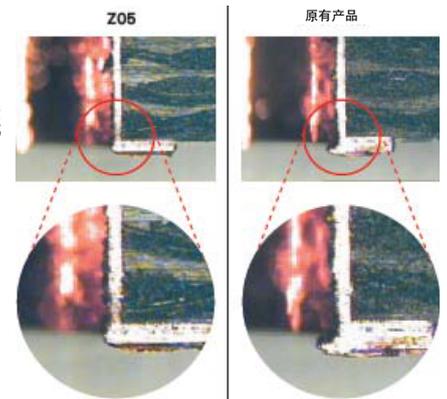


更加重视加工品质型 (D1A结合剂)

与以往产品相比，能够抑制切割刀片的刀刃变形，并且始终保持锋利的切割状态。

加工实例

毛边状态 (穿孔) 通过使用Z05, 可降低电极线毛边, 树脂毛边等的发生。



本公司的所有产品都已加入产品赔偿责任保险。

下订单时

在下订单时，请用户将产品的类型名称、外径、研削磨轮直径及数量通知本公司。另外在初次订购时，本公司销售窗口会根据不同加工要求，协助用户选择适合的产品，届时请一并提供研削材料、尺寸、形状、所用设备(装置)及其他相关加工条件等资料。

为了改进产品，本公司可能在未通知用户的情况下，就对产品规格进行变更，因此请仔细核对规格后再下订单。



为了安全使用本公司的各种产品

为了预防发生因研削磨轮、切割刀片(以下通称精密加工刀具)的破损而造成的各种事故和人身伤害，请严格遵守下列各注意事项。

- 请使用安全挡板 (包括喷嘴外壳或外盖)。
- 在使用注有限制旋转数的精密加工刀具时，请不要超出其规定的旋转数范围。
- 在安装精密加工刀具时，请遵照设备 (装置) 使用说明书的规定，正确地进行安装。
- 请不要使精密加工刀具掉落在地上，或发生碰撞。
- 在每次使用精密加工刀具前必须先进行检查，如果有缺口或其他破损，请停止使用。
- 在开始使用前，请仔细阅读相关设备 (装置) 的使用说明书。
- 请不要使用经过改装的设备 (装置)。
- 请不要使用不符合设备 (装置) 指定尺寸的精密加工刀具。
- 除了研削、切割及切削作业以外，请不要使用在其他用途。
- 在使用湿式研削、切割用精密加工刀具时，请使用冷却液。